



2020年3月4日

各 位

キャリア付き極薄銅箔「MicroThin™」、薄厚キャリア製品の量産開始 ～キャリアの厚みを18μmから12μmに薄厚化することで省資源、省エネに貢献します～

当社（社長：西田計治）は、キャリア付き極薄銅箔「MicroThin™」の新規製品となる薄厚キャリア製品の量産出荷を始めましたのでお知らせいたします。

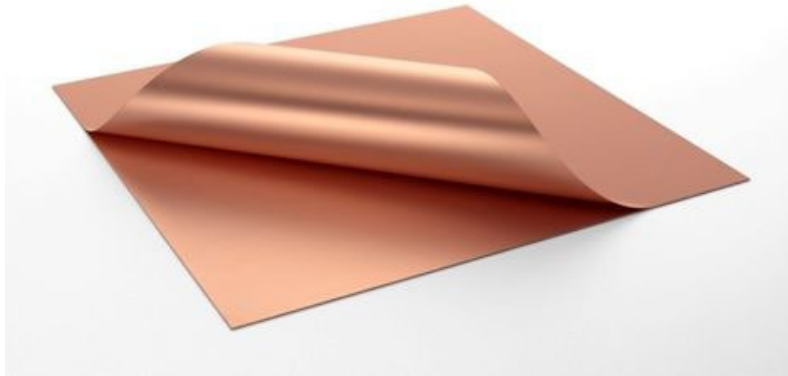
当社の「MicroThin™」は、微細回路形成に適した極薄銅箔（厚み1.5μm～5μm）とそれを支持するキャリア銅箔（既存製品厚み18μm）で構成されています。1300mmまでの広幅でロール出荷ができる事、ならびにキャリア剥離強度の安定性に優れている事からお客様の生産性向上と工程歩留向上に寄与できるため、高いご評価をいただいております。極薄銅箔側は回路形成用として使用され、キャリア銅箔はお客様の工程で剥ぎ取られリサイクル資源として再利用されております*1。

新規に開発した「MicroThin™」は、当社での価値創造活動を背景に、これまで18μm厚みであったキャリア銅箔を12μm厚みに薄厚化した製品です。これにより、当社を含めたサプライチェーン*2上では、以下の効果が期待されます。

- ① 「MicroThin™」製造時の銅原料の使用量削減、お客様の工程を含めたりサイクル・再利用にまわっていた量の削減により、銅資源の総循環量が減り省資源化が図れる。
- ② キャリア銅箔の薄厚化により、銅箔製造時のエネルギー削減、製品の重量減による輸送時のエネルギー削減につながり、省エネ化が図れる。

当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、安定した品質を維持し、お客様への十分な供給能力を確保してまいりますとともに、事業活動を通じ、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献します。

※ 1 : 「MicroThin™」 写真



上部 めくれている方：キャリア銅箔（厚み18 μ mと12 μ m）
下部：極薄銅箔（厚み 1.5 μ m～5 μ m）

※ 2 : サプライチェーン

原材料 ⇒ サプライヤーでのプロセス ⇒ 製造プロセス ⇒ お客様でのプロセス
⇒ 最終のお客様での使用・消費 ⇒ 廃棄 ⇒ リサイクル ⇒ 原料・・・ と続く一連の事業活動

<ご参考> SDGs(持続可能な開発目標)との関連

SDGs は 2015 年 9 月に国連加盟国の総会決議により採択された、2030 年までの 17 の開発目標です。今回の銅箔事業での活動は SDGs の下記 2 項目に関連しています。当社は SDGs の目標達成に向け貢献してまいります。

12 つくる責任 つかう責任
13 気候変動に具体的な対策を

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 Eメール PR@mitsui-kinzoku.com